22회 동 및 동합금 기술 강연회 일정표 (장소 : 성균관대학교 수원캠퍼스 종합연구동 8층 다목적 홀 / 일시 : 2009년 11월 20일 (금) 13:30 ~ 18:30)

13:00-13:30	접 수
13:30-13:40	개 회 한국 동 및 동합금 연구회 회장
13:40-14:20	환경친화적인 동합금 표면의 항균성 (Antimicrobial Copper Surface) 윤의한 기술연구소장, 대창공업(주)
14:20-15:10	Antimicrobial Copper Dr. Louis Koh, ICA
15:10-15:30	Coffee Break
15:30-15:50	플래쉬 솔루션으로서의 카드메모리향 패키지 시장 및 기술 동향 (Flash Solutions for Card Memory Package) - 한재환 선임연구원, 삼성전자 반도체총괄
15:50-16:10	TSV 및 High-stacked PKG향 요소분석기술로서의 미세국부 잔류응력 정량화 기술동향 (Quantification of Micropartial Residual Stress for TSV and High-Stacked Package) 이규제 선임연구원, 하이닉스반도체 연구소
16:10-16:30	3DI PKG향 비파괴적 특성분석 기술동향 (Non-destructive Analysis and Characterization for 3-Dimensional Integration Package) 이강원 주임연구원, 하이닉스반도체 연구소
16:30-16:50	Coffee Break
16:50-17:10	Flip Chip Bumping 응용제품의 시장 및 개발동향 (PCB Trends for Au Stud Bump Flip Chip Package) 이웅선 선임연구원, 하이닉스반도체 연구소
17:10-17:30	열전 에너지변환 소재 및 소자 연구동향 (Nanostructure Materials for Thermoelectric Devices) 김우철 교수, 연세대학교 기계공학부
17:30-18:00	사실상 국제표준 지원체계 구축사업 소개 서보석 과장, 한국화학시험연구원
18:00-18:30	글로벌 스탠다드 추진을 위한 국가 표준화 정책 이종현 연구관, 지식경제부 기술표준원
18:30-19:30	폐 회 / 조합사간 정보교류를 위한 만찬